

嘉兴斯达半导体股份有限公司

非公开发行 A 股股票预案修订说明

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“斯达半导”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于 2021 年 6 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，调整募投项目相关内容，并对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订了募投项目相关内容，将“高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目”分拆为“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC 芯片研发及产业化项目”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了募投项目相关内容，将“高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目”分拆为“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC 芯片研发及产业化项目”
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	修订了募投项目相关内容，将“高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目”分拆为“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC 芯片研发及产业化项目”
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、修订了募投项目的相关内容，将“高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目”的可行性分析分拆为“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC 芯

		片研发及产业化项目”的可行性分析 2、更新了“(三)功率半导体模块生产线自动化改造项目”中的“5、项目备案事项”
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	修订了“(三)募集资金投资项目风险”中募投项目的具体表述,将“高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目”分拆为“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC芯片研发及产业化项目”
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、更新了“(一)最近三年利润分配情况” 2、更新了“(二)最近三年现金分红情况”
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	1、修订了“(一)假设前提” 2、更新了“(二)对主要财务指标的影响”中的财务数据
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订了“(一)本次募投项目与公司现有业务的关系”中募投项目的具体表述,将“高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目”分拆为“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC芯片研发及产业化项目”

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021年6月16日